

# SIMSによる高濃度 $\text{BF}_2^+$ 注入Si中のBの定量分析

多田 陽子, 片岡 祐治  
富士通研究所 〒243-01 厚木市森の里若宮10-1

## SIMS Quantification for High-dose $\text{BF}_2^+$ -implanted Silicon

Yoko Tada, Yuji Kataoka  
FUJITSU LABS. LTD., 10-1, Morinosato-Wakamiya, Atsugi 243-01

### 1. はじめに

$\text{BF}_2^+$  を Si 基板中に高濃度で注入し、熱処理した試料の B, F の SIMS 深さプロファイルは、注入ビーグルの両側に新たに 2 つのビーグルを持った分布として観察されることが知られている。これらのビーグルは、一般に B, F が注入ダメージ領域に偏析しているものと考えられてきた。F については、拡散が早いことが知られており、ダメージ領域へ偏析している可能性が高い。しかし、B については、電気的に陰性の強い F が同じ深さに高濃度に存在するため、この F によるマトリックス効果を受けている可能性もある。また、一次イオンとして酸素を用い、この入射角を変化させた場合、B 分布が大きく変化するのに対し、F 分布の変化は小さい。これは、B の二次イオン強度が、表面酸素濃度が高いと酸素の影響が強く、逆に低いと F の影響を受けやすいことを示唆している。そこで、B の二次イオン強度が F のマトリックス効果を受けるかどうか調べ、 $\text{BF}_2^+$  を注入後、熱処理によりビーグルを形成する試料の B プロファイルの補正を試みた。

### 2. 実験

SIMS 分析には、ATOMIKA 社製、MODEL 6500 を用いた。深さ換算は、Dektak II 觸針式表面粗さ計を用いて実測した値を用いた。

B が F 濃度に依存して検出強度変化を起こすかどうか確認するため、B が均一に  $6.2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  含まれる Si ウェーハに、 $\text{F}^+$  を  $100 \text{ keV}, 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2}$  の条件で注入した試料を作製した。この試料から、B 二次イオン強度と F 濃度との関係式を作成した。

また、注入後の熱処理で、プロファイルがビーグルを形成する試料として、Si 基板に  $\text{BF}_2^+$  を  $35 \text{ keV}$ ,

$5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$  の条件で注入し、 $900^\circ\text{C}, 5\text{s}$  の熱処理を行った試料を作製した。この試料の F プロファイルと前記の関係式とから、補正式を作成し、B プロファイルを規格化することで、補正を行った。

### 3. 結果

B が均一に含まれる Si ウェーハの SIMS 分析から、均一なはずの B の二次イオン強度が、F 濃度分布に依存して変化を起こすことがわかった。これより、B は、F が高濃度に存在すると、二次イオン強度が変化することが確認された。また、B に対する F のマトリックス効果は、F 濃度がおよそ  $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  付近から生じ、B 二次イオン強度は、F 濃度に依存して指數関数的に増大した。

$\text{BF}_2^+$  を注入、熱処理した試料の補正前後の B プロファイルを図に示す。F プロファイルで補正式を作成しているため、深さ方向で変化する F のマトリックス効果が補正可能となっている。

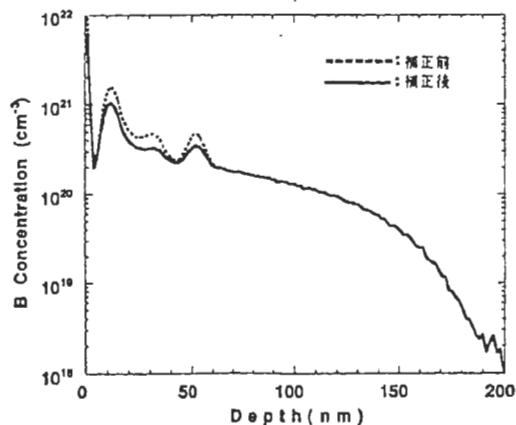


図 補正前後の B 深さプロファイル